

第48回 環境安全委員会 資料 2

東京PCB処理事業所 PCB廃棄物処理施設の解体撤去の 進捗状況

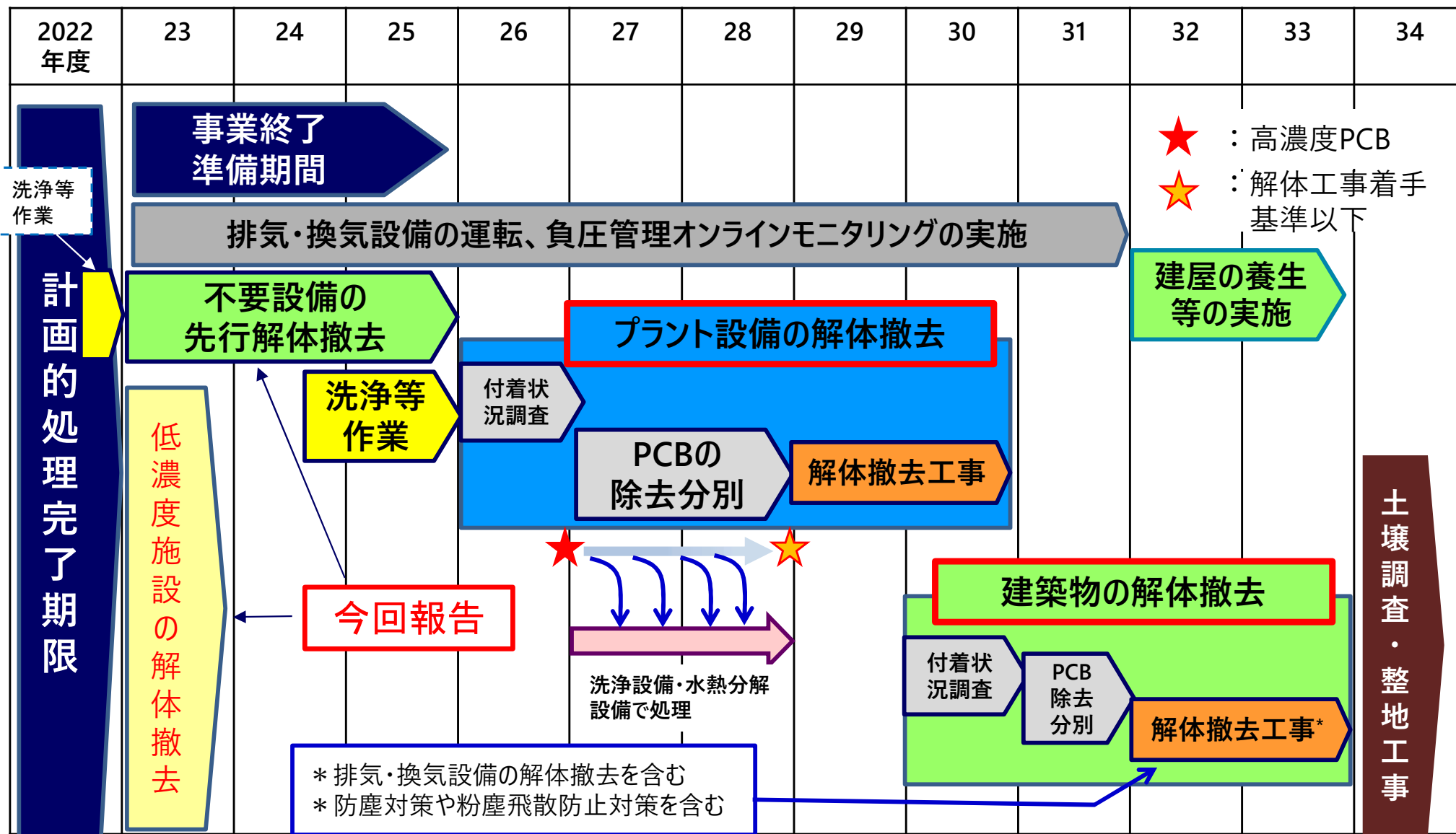
2023年3月30日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
東京PCB処理事業所

目次

- 1. 東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール …… 3
- 2. 低濃度PCB処理施設の解体撤去工事の進捗状況 …… 4
- 3. 不要設備の解体撤去の進捗状況 …… 6

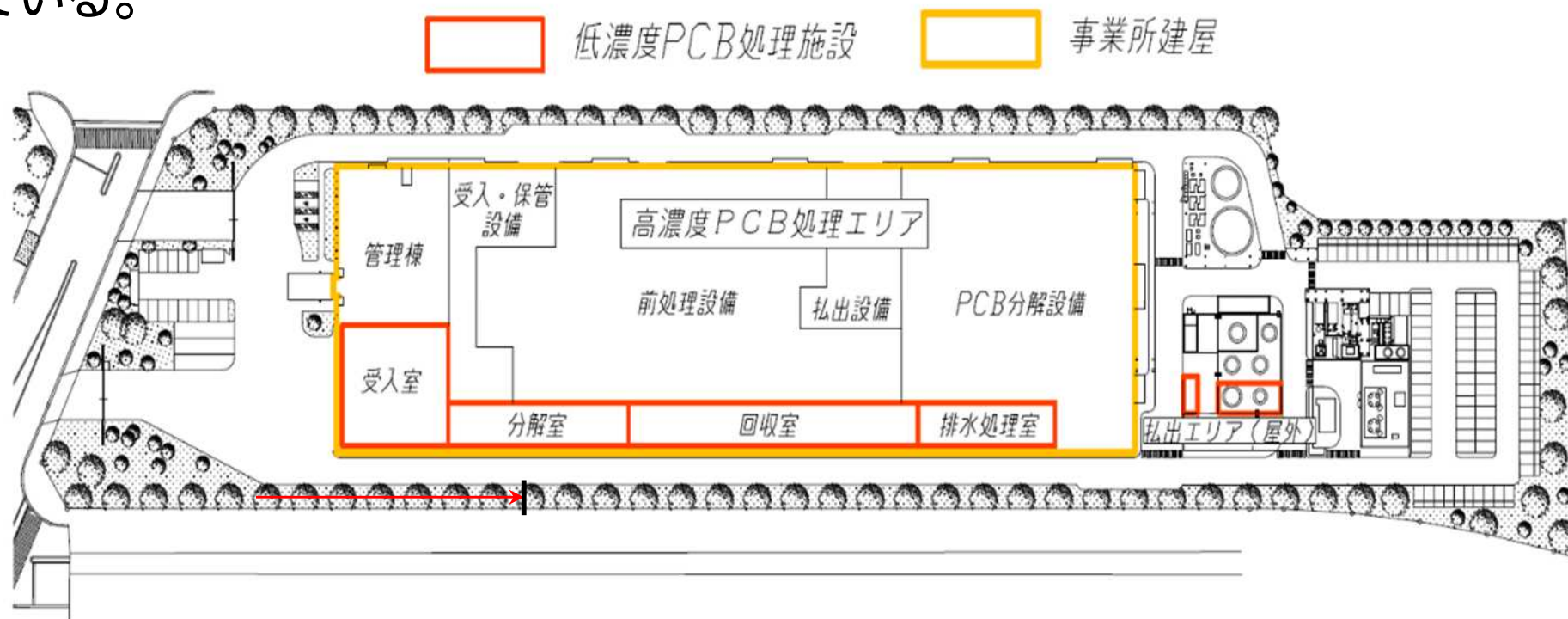
1. 東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール



2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去の概要

(1) 解体撤去工事の概要

低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事については、実施計画書を作成し、東京PCB処理事業部会(2022年8月1日開催)における審議、環境安全委員会(2022年12月1日開催)における意見聴取を経て成案とし、これに基づいて現在、発注準備を進めている。



2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の進捗状況

(2) 解体撤去工事スケジュール

○2023年8月着工を目指し、4月以降、発注手続きを進めて行く。

○解体工事の工期は8ヶ月、2023年度内の完了を予定している。

項 目		工 期 (月)						
		2023年 8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月
低濃度PCB 処理施設の 撤去工事	共通仮設工事	■						
	解体工事	■						

3. 不要設備の解体撤去の進捗状況

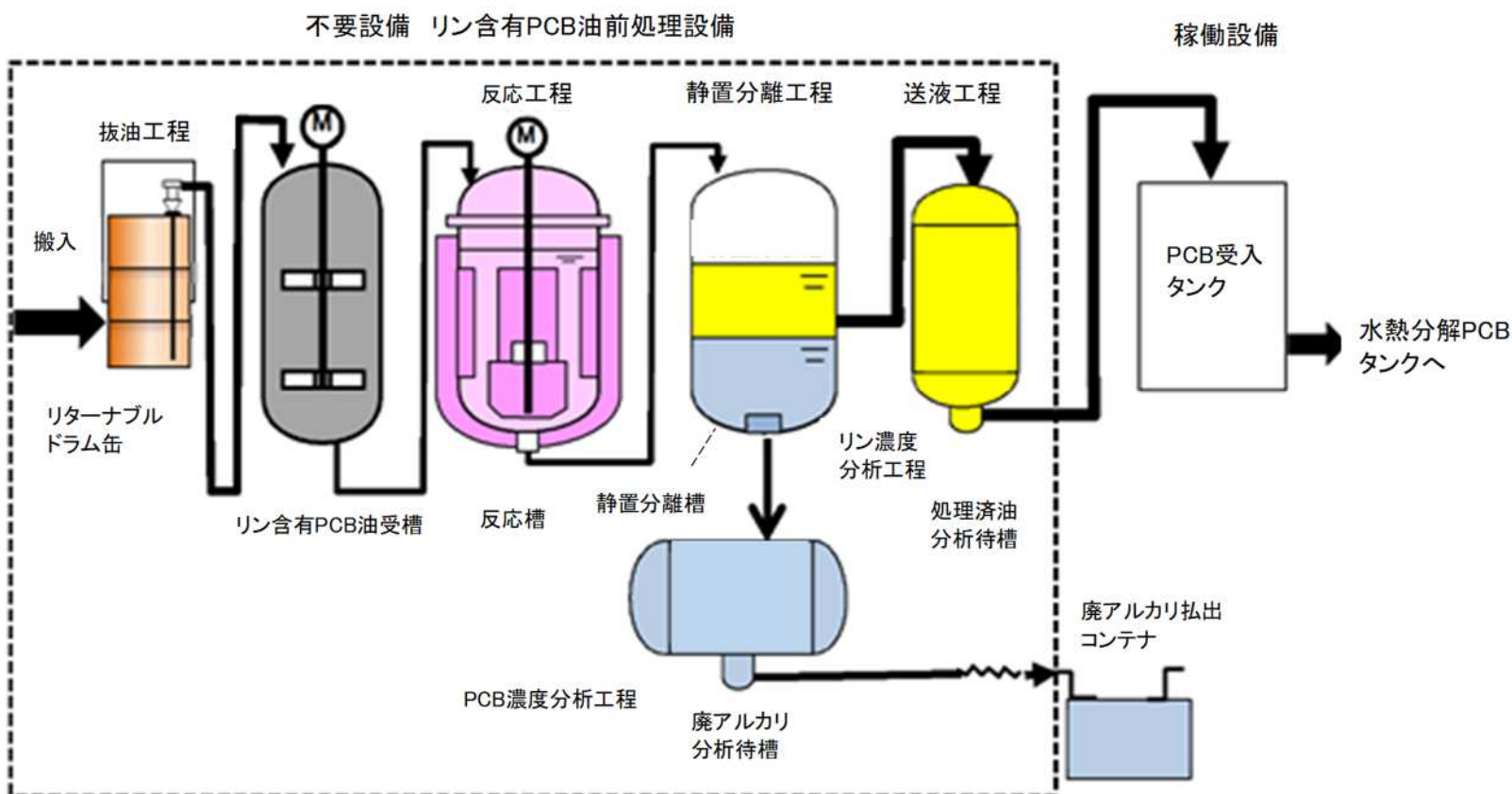
特例期間	事業終了準備期間			
	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
リン含有PCB油前処理設備	<p>洗浄</p>	<p>除去分別</p> <p>解体、前処理・洗浄</p> <p>有価売却、産廃/無害化处理委託</p>		
安定器等処理設備 ①予備洗浄装置	<p>洗浄</p>		<p>除去分別</p> <p>解体、前処理・洗浄</p> <p>有価売却、産廃/無害化处理委託</p>	
②破碎分別装置		<p>付着状況調査</p>	<p>除去分別</p>	<p>解体、前処理・洗浄</p> <p>有価売却、産廃/無害化处理委託</p>

3. 不要設備の解体撤去の進捗状況

1) リン含有PCB油前処理設備

(1) 洗浄運転の実施 (2022年12月～2023年2月)

- ・PCBを含まない絶縁油を洗浄液とし、配管、タンク・槽類の内部の洗浄を実施した。
- ・その結果、絶縁油中のPCB濃度が解体工事着手基準の1,000mg/kg以下になったことを確認した。

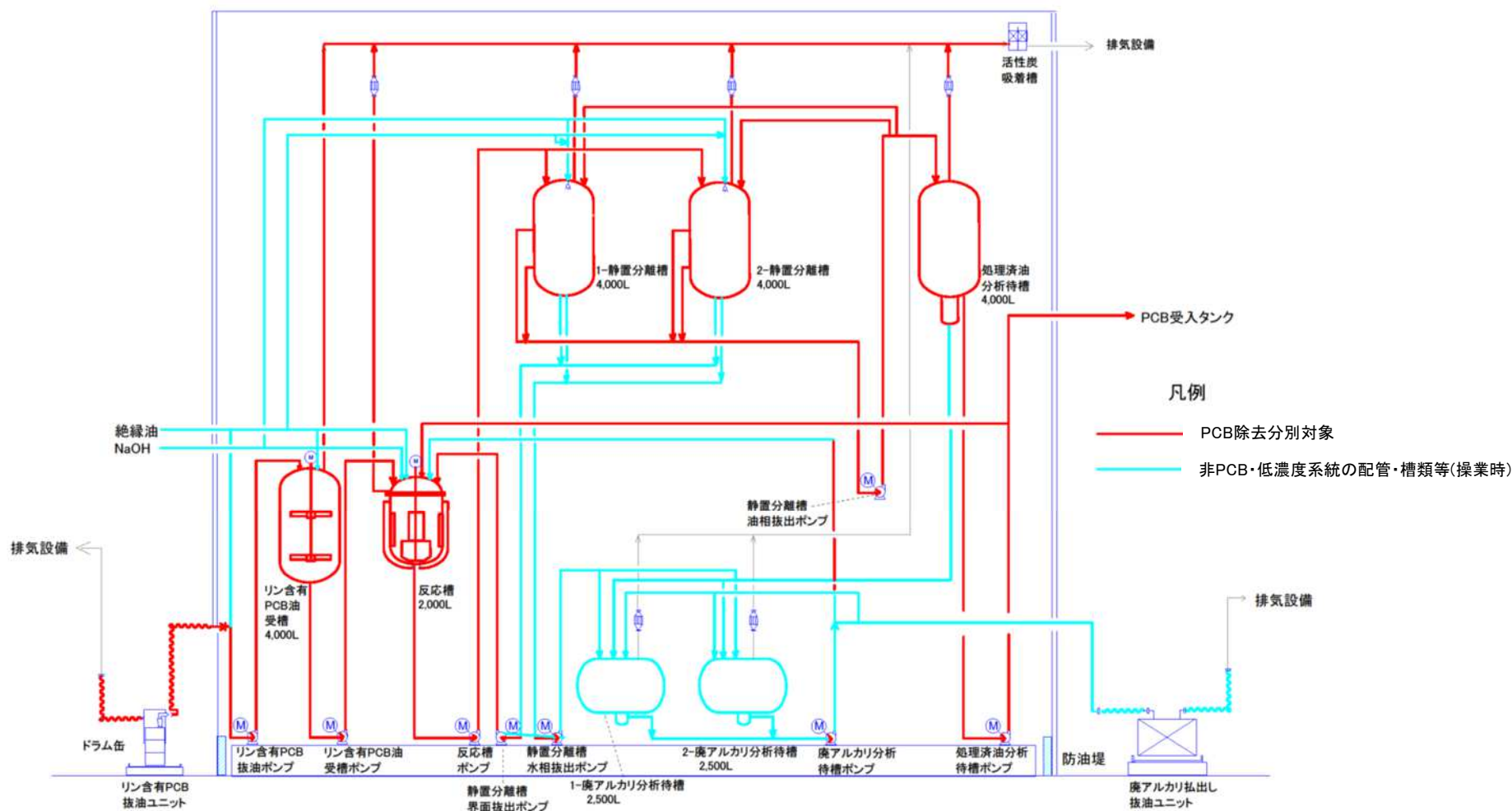


3. 不要設備の解体撤去の進捗状況

1) リン含有PCB油前処理設備

(2) PCB除去分別 (2023年度上期予定)

・リン含有PCB油が処理時に通液した配管・ポンプ・計器及びタンク・槽類(赤色)は、配管・ポンプ・計器類等とタンク・塔槽類に分けて除去分別を行う。

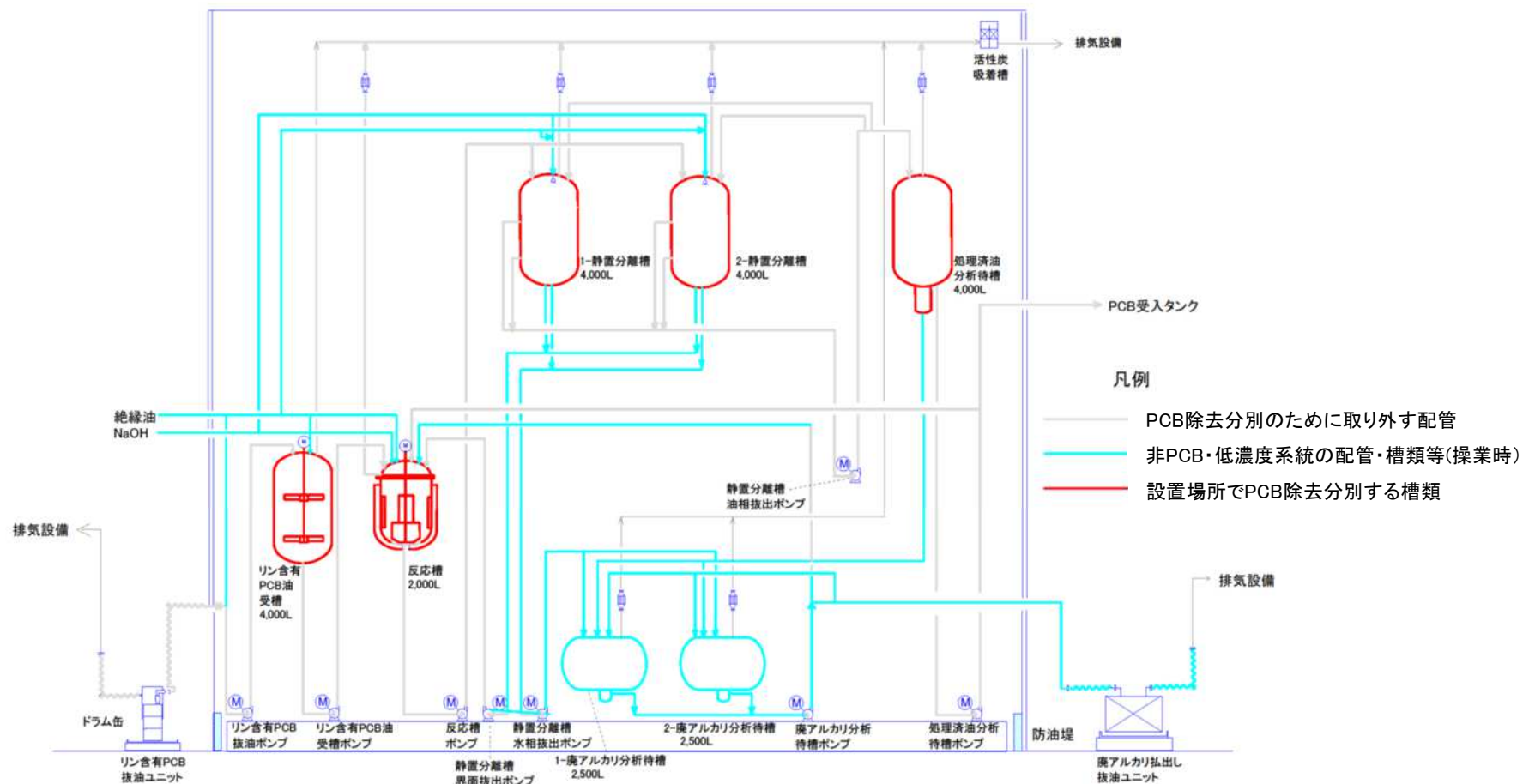


3.不要設備の解体撤去の進捗状況

1)リン含有PCB油前処理設備

(2)-①.PCB除去分別;配管・ポンプ・計器等(2023年度上期予定)

配管・ポンプ・計器等(グレイ色)は、構造が複雑な個所で高濃度PCBが残存している可能性があるため、取り外して、運転会社により変圧器やコンデンサーの処理と同様に分解・分別し、施設内の洗浄設備等で処理を行う。

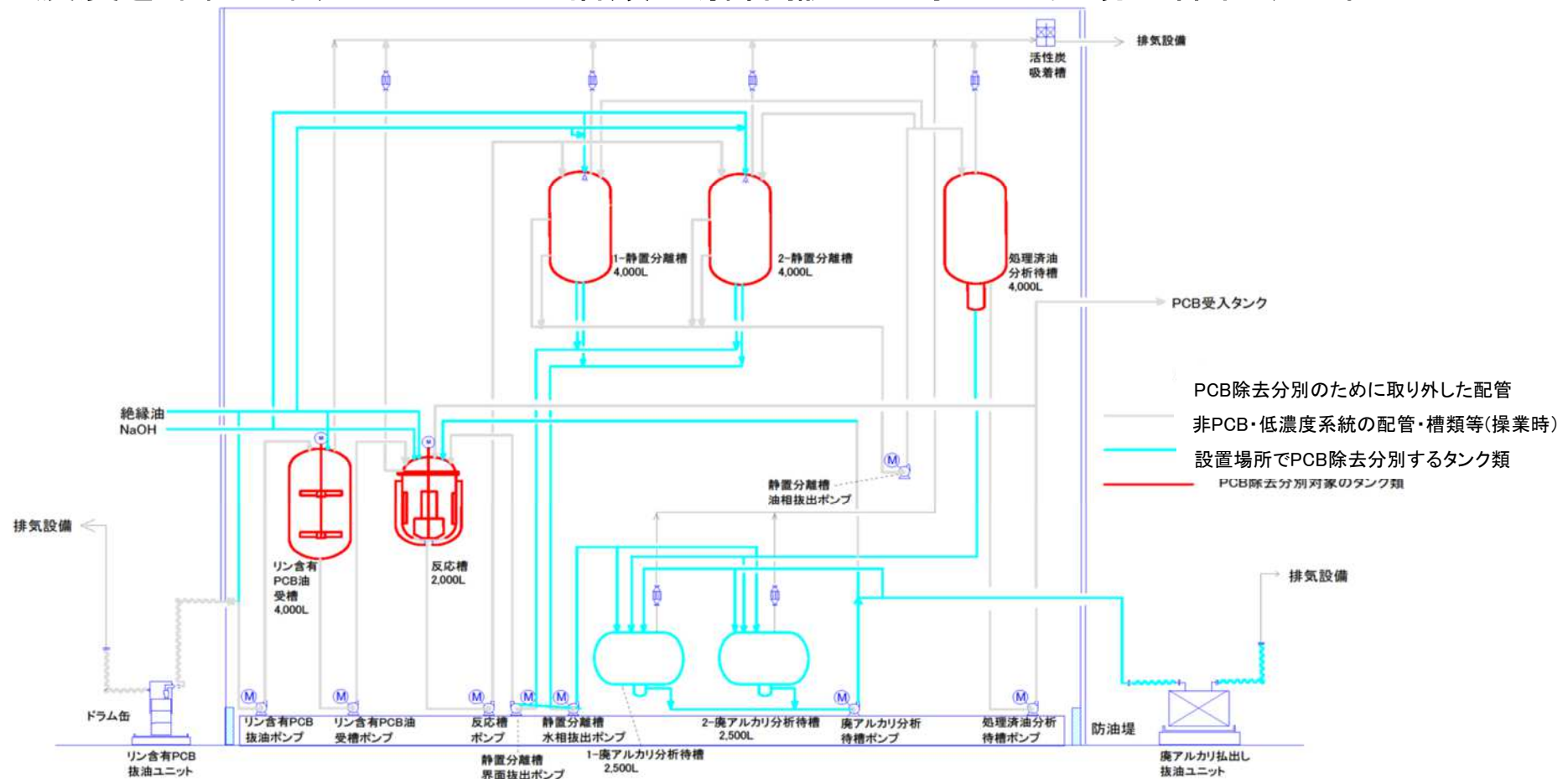


3. 不要設備の解体撤去の進捗状況

1) リン含有PCB油前処理設備

(2)-②.PCB除去分別;タンク・槽類 (2023年度上期予定)

タンクや槽類は、有姿で無害化処理認定施設へ払出する対象となる。
内表面の拭き取り検査により低濃度(1,000 $\mu\text{g}/100\text{cm}^2$ 以下)であることを確認して
高濃度が確認された場合は、拭き取りによる除去分別により低濃度とする。
低濃度を確認・確定したタンク・槽類は解体撤去工事まで現場で保存する。

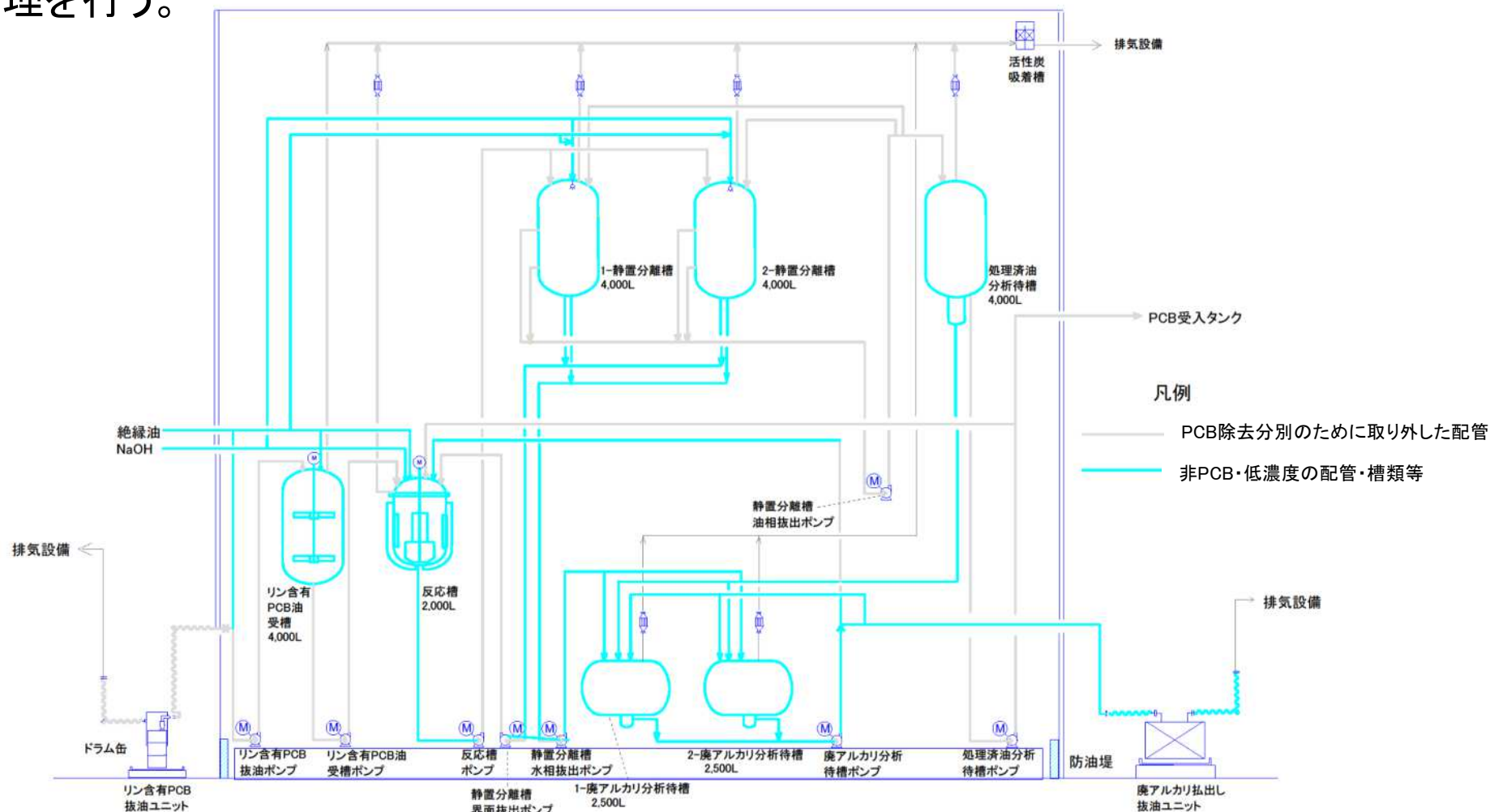


3.不要設備の解体撤去の進捗状況

1)リン含有PCB油前処理設備

(3)解体撤去工事 (2023年度下期)

低濃度まで除去分別したタンク・槽類、作業時に非PCB・低濃度系統であった配管等及びタンク・槽類は解体撤去工事で解体撤去し、無害化処理認定施設で適切に委託処理を行う。



3.不要設備の解体撤去の進捗状況

2)安定器等処理設備

(1)予備洗浄装置の洗浄運転 (2023年度上期予定)

PCBを含まない絶縁油を洗浄液として洗浄運転を行い、配管やタンク・槽類の内部のPCB濃度の低減を図る。

(2)破砕分別装置の付着状況調査 (2023年度下期予定)

(3)PCB除去分別/解体撤去工事 (2024~2025年度予定)

